

证券代码：002916

证券简称：深南电路

公告编号：2023-036

深南电路股份有限公司 2023 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	深南电路	股票代码	002916
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张丽君	谢丹	
办公地址	深圳市南山区侨城东路 99 号 5 楼	深圳市南山区侨城东路 99 号 5 楼	
电话	0755-86095188	0755-86095188	
电子信箱	stock@scc.com.cn	stock@scc.com.cn	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后

营业收入（元）	6,033,778,519.58	6,971,616,823.46	6,971,616,823.46	-13.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	473,932,042.81	752,100,693.05	752,470,663.16	-37.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	425,673,183.31	700,127,506.99	700,497,477.10	-39.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,219,835,545.99	1,632,272,255.99	1,632,272,255.99	-25.27%
基本每股收益（元/股）	0.92	1.49	1.49	-38.26%
稀释每股收益（元/股）	0.92	1.48	1.49	-38.26%
加权平均净资产收益率	3.84%	7.19%	7.19%	-3.35%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	20,357,577,727.02	20,726,545,628.78	20,732,418,282.96	-1.81%
归属于上市公司股东的净资产（元）	12,249,953,316.13	12,249,407,783.16	12,251,659,553.96	-0.01%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于 2022 年 11 月 30 日发布实施《企业会计准则解释第 16 号》，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，自 2023 年 1 月 1 日起施行。对于在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本公司按照该规定和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	67,881	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中航国际控股有限公司	国有法人	63.97%	328,068,670	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	3.12%	15,999,989	0		
国新投资有限公司	国有法人	1.39%	7,132,294	0		
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	其他	0.97%	4,986,060	0		
李雪红	境内自然人	0.57%	2,935,000	0		
华芯投资管理有限责任公司—国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	其他	0.54%	2,787,585	0		
山东省国有资产投资控股有限公司	国有法人	0.42%	2,176,900	0		
GIC PRIVATE LIMITED	境外法人	0.30%	1,558,859	0		
中国人寿保险股份	其他	0.30%	1,532,831	0		

有限公司—万能— 国寿瑞安						
中航产业投资有限 公司	国有法人	0.27%	1,393,792	1,393,792		
上述股东关联关系或一致行动的 说明	中航国际控股有限公司、中航产业投资有限公司受同一控制方控制，公司未知其他股东是否存在其他关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	股东李雪红通过信用交易担保证券账户持有 2,935,000 股，实际合计持有 2,935,000 股					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

1、2023 年上半年经营情况

2023 年上半年，国际形势复杂多变，全球各大主要经济体的制造业 PMI 普遍持续处于荣枯线下，全球经济放缓的压力依旧存在。电子产业受经济环境影响较为显著，整体需求承压。

公司积极应对外部环境带来的挑战，通过开发新客户、强化运营提升效率、严控费用等举措降低需求弱化带来的冲击。报告期内，公司实现营业总收入 60.34 亿元，同比下滑 13.45%；归属于上市公司股东的净利润 4.74 亿元，同比下降 37.02 %。上述变动主要是由于公司 PCB 及封装基板业务下游市场需求同比下行，叠加公司新项目建设、新工厂产能爬坡等因素共同影响。在上半年经营承压的背景下，公司坚定有序推进研发工作，封装基板高阶产品领域取得技术突破。

(1) 印制电路板业务需求承压，重点聚焦拓展客户

报告期内，公司印制电路板业务实现主营业务收入 38.82 亿元，同比下降 12.43%，占公司营业总收入的 64.33%；毛利率 25.85%，同比下降 1.49 个百分点。

通信领域，2023 年上半年国内通信市场需求未出现明显改善，海外通信市场需求受到局部地区 5G 建设项目进展延缓影响，报告期内，公司通信领域订单规模同比略有下降。公司积极应对市场环境带来的挑战，凭借行业领先的技术与高效优质的服务，在现有客户群中实现订单份额稳中有升，同时，公司加大力度推进新客户开发工作。

数据中心领域，2023 年上半年由于全球经济降温 and Eagle Stream 平台切换不断推迟，数据中心总体需求依旧承压，公司 AI 服务器相关 PCB 产品目前占比较低，对营收贡献相对有限。报告期内，公司数据中心领域总体订单同比有所减少。

汽车电子领域，公司积极把握新能源和 ADAS 方向带来的增长机会，相关订单同比增长近 40%。一方面，公司前期导入的新客户定点项目需求逐步释放；另一方面，公司深度开发现有客户项目贡献增量订单。汽车电子专业 PCB 工厂南通三期产能爬坡工作稳步推进，为公司汽车电子订单的导入提供产能支撑。

报告期内，PCB 业务持续推进运营能力提升。公司以争取订单并落实交付为出发点，开展项目研究，提升工艺制程和平台运营能力，满足业务拓展对内部管理的更高要求；通过加强成本费用管控，促进人效提升，实现高质量挖潜增效。

2023 年下半年，公司 PCB 业务将继续聚焦拓展客户，积极把握数据中心领域 Eagle Stream 平台逐步切换带来的机会，争取汽车电子重点客户新定点项目。与此同时，公司将扎实推进质量管理和成本管理能力提升，强化 PCB 业务技术与成本竞争力。

(2) 封装基板业务保持战略定力，持续推进高端市场布局

报告期内，公司封装基板业务实现主营业务收入 8.21 亿元，同比下降 39.90%，占公司营业总收入的 13.61%；毛利率 18.80%。

报告期内，全球半导体景气持续低迷，下游厂商去库存现象依旧普遍。受此影响，公司各类封装基板产品订单较去年同期均出现了不同程度的下滑。公司凭借自身广泛的 BT 类封装基板产品覆盖能力，积极导入新项目，开发新客户，特别在存储类、射频模组类、FC-CSP 类产品市场取得深耕成果，把握了今年第二季度封装基板领域局部出现的需求修复机会。

技术能力突破方面，公司 FC-CSP 产品在 MSAP 和 ETS 工艺的样品能力已达到行业内领先水平；RF 射频产品成功导入部分高阶产品类别；FC-BGA 中阶产品目前已在客户端顺利完成认证，部分中高阶产品已进入送样阶段，高阶产品技术研发顺利进入中后期阶段，现已初步建成高阶产品样品试产能力。

新项目建设方面，无锡基板二期工厂能力建设稳步推进，产线能力得到持续验证与提升，目前处于产能爬坡阶段。广州封装基板项目建设推进顺利，其中一期厂房及配套设施建设和机电安装工程已基本完工，生产设备已陆续进厂安装，预计将于 2023 年第四季度连线投产。报告期内，无锡二期基板工厂和广州封装基板项目带来的成本和费用增加对公司利润造成一定负向影响。

2023 年下半年，公司封装基板业务将继续重点聚焦新项目导入、大客户开发、关键工艺能力建设等工作，降低行业需求波动带来的冲击，同时，为广州封装基板项目提前做好订单与能力储备。

(3) 电子装联业务发力拓展，业务附加值持续提升

报告期内，公司电子装联业务实现主营业务收入 8.50 亿元，同比增长 20.33%，占公司营业总收入的 14.10%；毛利率 15.80%，同比下降 1.84 个百分点。

2023 年上半年，公司电子装联业务继续加大在医疗、数据中心、汽车等领域的开发与深耕。其中，医疗领域公司凭借行业领先的技术与高效优质的服务，提升了客户粘性及主要大客户处份额占比；数据中心领域，公司通过提供更多具备自主知识产权的高附加值服务，在进一步稳固与客户合作关系的同时改善了自身盈利能力；汽车电子领域，公司通过持续努力，增加客户数量并扩大项目覆盖，在拉高收入规模同时降低部分项目需求波动的影响。内部运营上，公司继续加强精细化管理与人员效率提升相关工作，保障了业务整体盈利。

2023 年下半年，公司电子装联业务将继续重点把握医疗、数据中心、汽车等市场领域的机会，做好新项目争取与新客户开发工作，加强在研发、设计、供应链管理方面的响应与协同能力，提升客户服务能力。内部运营层面将继续加强项目管理能力，丰富智能制造管理实践，促进运营效率提升，提升盈利空间。

(4) 深入落实数字化转型，促进运营能力稳步提升

报告期内，公司持续深入推进流程变革与数字化转型工作，深化落实从制程、运营、流程等维度的数字化协同管理举措，加快向流程型组织转变。其中，部分数字化管理举措均已取得较好的试点效果，现已逐步向内部推广或复制，数字化能力建设有序推进。通过一系列数字化手段赋能，公司进一步提升质量管理能力和生产经营效率，促进内部精益持续改善，并同步增强对客户的高效服务能力，实现服务保障水平与各业务日益拓宽的客户版图相匹配。

(5) 研发创新能力稳步提升，关键产品技术实现突破

公司长期坚持技术领先战略，以技术发展为第一驱动力，高度重视技术与产品的研发工作，持续加大研发投入规模，不断提升研发和创新能力。报告期内，公司研发投入占营收比重 6.24%，同比提升 0.49 个百分点。公司各项研发项目进展顺利，通信、数据中心及汽车电子相关 PCB 技术研发，以及 FC-BGA 类基板产品能力建设，FC-CSP 精细线路基板和射频基板技术能力提升等项目均按期稳步推进并取得阶段性进展。新增授权专利 55 项，新申请 PCT 专利 5 项，多项产品、技术达到国内、国际领先水平。

2、子公司重要事项

根据公司业务发展情况需要，结合公司整体经营发展规划及各子公司业务定位，经有权国资监管单位审核，公司将持有的涉及封装基板业务的相关资产无偿划转至全资子公司深圳广芯封装基板有限公司，将无锡深南电路有限公司持有的涉及封装基板业务的相关资产无偿划转至无锡广芯封装基板有限公司，本次划转的封装基板业务包括高阶倒装芯片用 IC 载板产品制造项目，因此募投项目实施主体由无锡深南电路有限公司变更为无锡广芯封装基板有限公司。本次资产划转属于公司内部资源整合优化，不涉及现金支付，对公司财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。